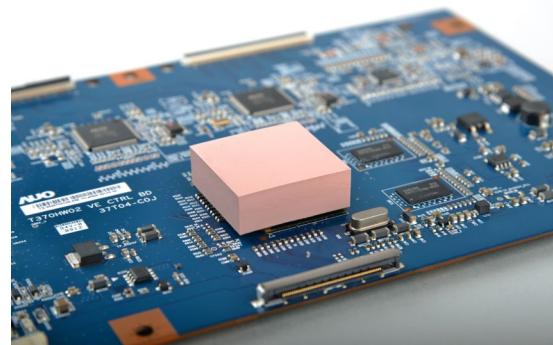


高导热硅胶垫片

TP600-H60-9导热硅胶片是一款高导热性能的材料，双面自粘，与电子组件装配使用时，低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性。在-40°C~150°C可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。



特性和优点

- 导热系数: 6.0W/(m·K)
- 高导热
- 超低压缩
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 韧性好易操作

典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

典型属性

| 属性 | 典型值 | 测试方法 |
|--|------------------|----------------------|
| 颜色 | 暖红色 | 目视 |
| 厚度(mm) | 0.5~10.0 | ASTM D374 |
| 密度(g/cc) | 3.285 | ASTM D792 |
| 硬度(Shore 00) | 60 | ASTM D2240 |
| 重量损失(%), 挥发、渗出) | ≤1.0 | 滤纸吸附@压缩25%/125°C/48h |
| 耐温范围(°C) | -40~150 | / |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 保质期(月) | 12 | 温度<40°C避免挤压、暴晒 |
| 电性能 | | |
| 击穿电压(kV/mm) | >5.0 | ASTM D149 |
| 介电常数(@1MHz) | 7.9 | ASTM D150 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | 10 ¹² | ASTM D257 |
| 导热性能 | | |
| 导热系数(W/(m·K)) | 6.0 | ISO 22007-2 |
| 热阻(°C·in ² /W @20psi,1.0mm) | 0.138 | ASTM D5470 |